

PŁYTY PCW SPIENIONE

DANE TECHNICZNE

Grubość w mm	Wymiary standardowe	
1	2050 x 3050 1560 x 3050 1220 x 3050 1220 x 2440	
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
19		1560x3050

SKŁADOWANIE, OBRÓBKA, MONTAŻ

OBRÓBKA

- zadruk cyfrowy (tylko lekkie płyty spienione)
- sitodruk (tylko lekkie płyty spienione)
- gięcie na gorąco
- frezowanie
- sztancowanie
- wiercenie
- klejenie
- cięcie gilotyną

TRANSPORT

Płyty należy transportować ostrożnie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczając powierzchnię przed zarysowaniem. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się w sposób, który zapewni ochronę płyt przed uszkodzeniem mechanicznym.

SKŁADOWANIE

Płyty należy składować w pozycji poziomej na palecie w suchym pomieszczeniu wewnątrz budynku. Przechowywanie w temperaturze nie wyższej niż 40C, unikając bezpośredniego światła słonecznego.

W przypadku przechowywania płyt w okresie zimy w pomieszczeniach nieogrzewanych płyty przed użyciem do obróbki należy kondycjonować co najmniej 72 h w temperaturze 15C. Pakiety płyt powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Należy unikać kontaktu z innymi substancjami, takimi jak oleje, smary, rozpuszczalniki.